

TSMC, 18인치 웨이퍼 양산 연기

2015년에서 2018년으로 3년 늦춰 ... 신규장비 개발 지연으로

세계 최대의 반도체 수탁 생산기업인 타이완 TSMC가 차세대 18인치 웨이퍼 양산시기를 늦추었다.

영자지 타이베이 타임스 등에 따르면, TSMC는 9월4일 타이베이에서 설명회를 통해 2018년부터 18인치 웨이퍼 양산체제에 들어갈 계획이라고 밝혔다.

2015년까지 양산 시스템을 구축하겠다는 기존 발표보다 3년 늦은 것이다.

TSMC는 “웨이퍼 생산을 위한 신규장비 개발이 늦어졌기 때문”이라며 “2016년 또는 2017년 18인치 웨이퍼의 시험생산을 시작할 예정”이라고 밝혔다.

시장 관계자들은 18인치 웨이퍼가 본격 생산되면 기존 12인치에 비해 2.5배의 반도체 칩을 얻을 수 있어 생산원가 부담이 크게 줄어든 것으로 예상하고 있다.

TSMC는 2012년 85억달러(약 9조6000억원)를 반도체 장비 구매에 투자할 계획이며, 장비개발 지원을 위해 8월 반도체 칩 장비 세계 1위인 네덜란드 ASML의 지분 5%를 인수하기로 결정했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2012/09/05>